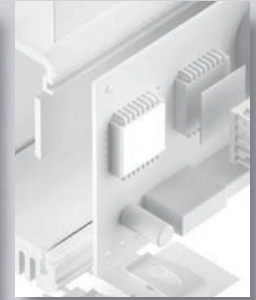


SILIKONFREIE WÄRMELEITPASTE TGR-M-NS HALA

hoch termisch leitfähig

TGR-M-NS ist eine thermisch sehr leitfähige Paste auf der Basis einer silikonfreien Matrix aus Esteröl. Mit ihr lassen sich sehr gute und hochzuverlässige thermische Anbindungen elektronischer Bauelemente erreichen. Durch die Formulierung und Füllung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine hohe thermische Leitfähigkeit. Durch ihren Einsatz werden der thermische Kontakt- und Gesamtübergangswiderstand minimiert.



Stand 11 / 2018

EIGENSCHAFTEN

- Wärmeleitfähigkeit: 2,4 W/mK
- Silikonfrei
- Dispensierbar
- Fast drucklose Aufbringung
- Dielektrisch durchschlagsfest
- Betriebstemperaturbereich: - 40 bis 150°C

LIEFERFORMEN

- Kartusche
- Behälter 1 kg
- Auf Anfrage

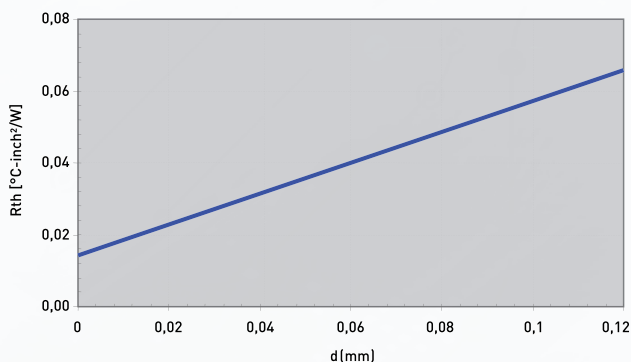
ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

- LED Boards
 - Leistungsmodulen
 - RDRAM Speicherbausteine
 - Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
- z.B. in Automotiveanwendungen / Leistungselektronik / Lichttechnik / Industriecomputer

Eigenschaft	Einheit	TGR-M-NS
Material		Keramik gefüllte Wärmeleitpaste
Farbe		Weiss
Dichte	g / cm ³	3,2
Viskosität (Brookfield @ 10 rpm, 25 °C)	Pas	110
RoHS Konformität	2011 / 65 / EU	Ja
Thermisch		
Thermische Leitfähigkeit	W/mK	2,4
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150
Lagertemperatur	°C	< 35 °C
Lagerzeit	Monate @ RT	12
Elektrisch		
Durchschlagsfestigkeit	kV / mm	4,5

Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.



Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktanwendung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.